

## ⑫ 公開実用新案公報(U)

平2-45699

⑬ Int. Cl.<sup>5</sup>H 05 K 9/00  
3/28  
9/00

識別記号

R 7039-5E  
G 6736-5E  
P 7039-5E

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)3月29日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全1頁)

⑮ 考案の名称 シールド付き電子回路基板

⑯ 実 願 昭63-124078

⑰ 出 願 昭63(1988)9月22日

⑱ 考 案 者 杉 浦 弘 毅 愛知県大府市共和町長根山1番地 東海興業株式会社内

⑲ 出 願 人 東海興業株式会社 愛知県大府市共和町長根山1番地

⑳ 代 理 人 弁理士 岡田 英彦 外3名

## ㉑ 実用新案登録請求の範囲

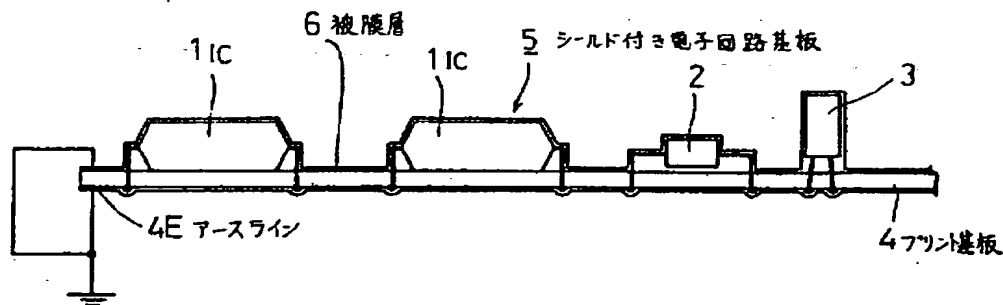
(1) 電子回路素子のそれぞれを所定位置に装着し、それぞれの電子回路素子を電氣的に接続して電子回路を構成した電子回路基板の表面に絶縁薄膜を形成したあと、この絶縁薄膜の表面に静電及び電磁シールド可能な導電性シールド薄膜を形成し、この導電性シールド薄膜を前記電子回路基板に形成されたアースラインに接続したことを特徴とするシールド付き電子回路基板。

(2) 前記導電性シールド薄膜を金属蒸着膜としたことを特徴とする請求項第1項記載のシールド付き電子回路基板。

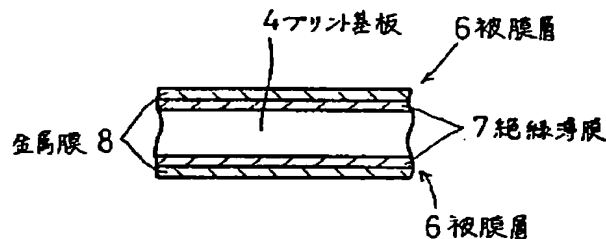
## 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例の側断面図、第2図は第1図の詳細断面図である。

1……IC(集積回路素子)、2……抵抗、3……キャパシタ、4……プリント基板、4E……アースライン、5……シールド付き電子回路基板、6……被膜層、7……絶縁薄膜、8……金属膜。



第 1 図



第 2 図